

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-163634

(43) 公開日 平成10年(1998) 6月19日

(51) Int.Cl.⁶

H 0 5 K 3/46

識別記号

F I

H 0 5 K 3/46

Q

E

審査請求 未請求 請求項の数 2 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願平8-316445

(22) 出願日 平成 8 年(1996) 11月27日

(71) 出願人 000006633

京セラ株式会社

京都府京都市山科区東野北井ノ上町 5 番地
の22

(72) 発明者 若崎 昭

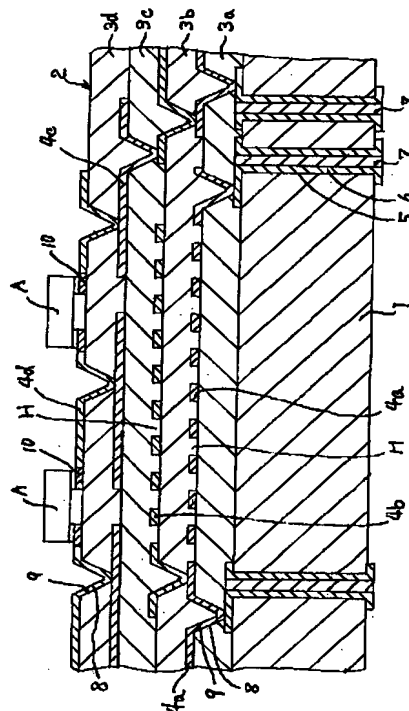
鹿児島県国分市山下町 1 番 1 号 京セラ株
式会社鹿児島国分工場内

(54) 【発明の名称】 多層配線基板

(57) 【要約】

【課題】 電源用薄膜配線導体層と接地用薄膜配線導体層とが間に介在する有機樹脂絶縁層に形成されたボイドによって短絡してしまう。

【解決手段】 基板 1 上に、複数の有機樹脂絶縁層 3 a、3 b、3 c、3 d を多層に被着させるとともに該有機樹脂絶縁層 3 a、3 b、3 c、3 d 間に電源用薄膜配線導体層 4 a、接地用薄膜配線導体層 4 b 及び信号用薄膜配線導体層 4 c、4 d を配してなる多層配線基板であって、前記電源用薄膜配線導体層 4 a 及び接地用薄膜配線導体層 4 b は、その各々が複数の開口 H を格子状に配したメッシュ状をなしており、かつ電源用薄膜配線導体層 4 a の導体部が接地用薄膜配線導体層 4 b の開口 H に、また接地用薄膜配線導体層 4 b の導体部が電源用薄膜配線導体層 4 a の開口 H に各々対向している。



【特許請求の範囲】

【請求項1】基板上に、複数の有機樹脂絶縁層を多層に被着させるとともに該有機樹脂絶縁層間に電源用薄膜配線導体層、接地用薄膜配線導体層及び信号用薄膜配線導体層を配してなる多層配線基板であって、前記電源用薄膜配線導体層及び接地用薄膜配線導体層は、その各々が複数の開口を格子状に配したメッシュ状をなしており、かつ電源用薄膜配線導体層の導体部が接地用薄膜配線導体層の開口に、また接地用薄膜配線導体層の導体部が電源用薄膜配線導体層の開口に各々対向していることを特徴とする多層配線基板。

【請求項2】前記メッシュ状をなす電源用薄膜配線導体層及び接地用薄膜配線導体層の各開口の面積が $2.5 \times 10^{-3} (\text{mm}^2)$ 乃至 $9.0 \times 10^{-3} (\text{mm}^2)$ であり、全開口面積が電源用薄膜配線導体層及び接地用薄膜配線導体層の各々の全面積に対し5%乃至30%であることを特徴とする請求項1に記載の多層配線基板。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、多層配線基板に関し、より詳細には混成集積回路装置や半導体素子を收容する半導体素子収納用パッケージ等に使用される多層配線基板に関するものである。

【0002】

【従来の技術】従来、混成集積回路装置や半導体素子収納用パッケージ等に使用される多層配線基板はその配線導体がMo-Mn法等の厚膜形成技術によって形成されている。

【0003】このMo-Mn法は通常、タングステン、モリブデン、マンガン等の高融点金属粉末に有機溶剤、溶媒を添加混合し、ペースト状となした金属ペーストを生セラミック体の外表面にスクリーン印刷法により所定パターンに印刷塗布し、次にこれを複数枚積層するとともに還元雰囲気中で焼成し、高融点金属粉末と生セラミック体とを焼結一体化させる方法である。

【0004】なお、前記配線導体が形成されるセラミック体としては通常、酸化アルミニウム質焼結体やムライト質焼結体等の酸化物系セラミックス、或いは表面に酸化物膜を被着させた窒化アルミニウム質焼結体や炭化珪素質焼結体等の非酸化物系セラミックスが使用される。

【0005】しかしながら、このMo-Mn法を用いて配線導体を形成した場合、配線導体は金属ペーストをスクリーン印刷することにより形成されることから微細化が困難で、配線導体を高密度に形成することができないという欠点を有していた。そこで、上記欠点を解消するために配線導体を従来周知の厚膜形成技術により形成するのに代えて微細化が可能な薄膜形成技術を用いて高密度に形成した多層配線基板が使用されるようになってきた。

【0006】かかる配線導体を薄膜形成技術により形成

(2)

10

20

30

40

50

した多層配線基板は、酸化アルミニウム質焼結体から成るセラミックスやガラス繊維を織り込んだガラス布にエポキシ樹脂を含浸させて形成されるガラスエポキシ樹脂等から成る基板の上面にスピコート法及び熱硬化処理によって形成されるエポキシ樹脂等の有機樹脂から成る絶縁層と、銅やアルミニウム等の金属を無電解メッキ法や蒸着法等の薄膜形成技術及びフォトリソグラフィ技術を採用することによって形成される電源用、接地用及び信号用の各薄膜配線導体層とを交互に積層させた構造を有しており、最上層の有機樹脂絶縁層の上面には前記電源用、接地用及び信号用の各薄膜配線導体層と電気的に接続するボンディングパッドが形成されており、該ボンディングパッドに半導体素子等の能動部品や容量素子、抵抗器等の受動部品の電極が熱圧着等により接合され、これによって電源用、接地用及び信号用の各薄膜配線導体層に半導体素子等の電源端子、接地端子及び信号端子が電気的に接続されるようになっている。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、この有機樹脂絶縁層と電源用、接地用及び信号用の各薄膜配線導体層とを交互に積層して成る多層配線基板は、電源用薄膜配線導体層及び接地用薄膜配線導体層を流れる電流が大きく、その流れる電流に耐え得るようにするために、また信号用薄膜配線導体層の特性インピーダンスを整合させるために有機樹脂絶縁層間のほぼ全面にわたる広面積に形成されており、広面積の電源用薄膜配線導体層と接地用薄膜配線導体層とを間に有機樹脂絶縁層を挟んで形成すると有機樹脂絶縁層を熱硬化させる際に発生するガスが前記電源用薄膜配線導体層及び接地用薄膜配線導体層によって外部に放出されるのが阻止され、その結果、電源用薄膜配線導体層及び接地用薄膜配線導体層と有機樹脂絶縁層との間に不要なガスが溜まり、有機樹脂絶縁層と電源用及び接地用薄膜配線導体層との接合強度が大きく低下してしまうという欠点を招来した。

【0008】そこで前記有機樹脂絶縁層を間に挟んで形成されている電源用薄膜配線導体層と接地用薄膜配線導体層の各々の対向領域に複数の開口を格子状に配してメッシュ状となし、該開口を介して有機樹脂絶縁層が熱硬化時に発する不要なガスを外部良好に放出させることが考えられる。

【0009】しかしながら、電源用薄膜配線導体層と接地用薄膜配線導体層の各々の対向領域に開口を設けた場合、電源用薄膜配線導体層と接地用薄膜配線導体層の各々の導体部が間に有機樹脂絶縁層を挟んで対向することとなり、有機樹脂絶縁層はその厚みが $5 \mu\text{m} \sim 30 \mu\text{m}$ 程度と薄いことから上下に貫通するボイド（穴）が形成され易く、ボイド（穴）が形成されていると、該ボイドを介して電源用薄膜配線導体層と接地用薄膜配線導体層とが電気的に短絡し、多層配線基板としての機能が喪失してしまうという欠点を誘発した。

【0010】本発明は上述の欠点を鑑み案出されたもので、その目的は配線導体の一部もしくは全部を薄膜形成技術により形成し、配線導体を高密度に形成したことを特徴とする多層配線基板を提供することにある。

【0011】また本発明の他の目的は有機樹脂絶縁層を熱硬化させる際に発生する不要なガスを外部に効率良く放出させ、有機樹脂絶縁層と各薄膜配線導体層とを強固に接合させた多層配線基板を提供することにある。

【0012】更に本発明の他の目的は有機樹脂絶縁層を間に挟んで対向配置される電源用薄膜配線導体層と接地用薄膜配線導体層との電気的絶縁を良好として多層配線基板としての機能を長期間にわたり発揮させることができる多層配線基板を提供することにある。

【0013】

【課題を解決するための手段】本発明は、基板上に、複数の有機樹脂絶縁層を多層に被着させるとともに該有機樹脂絶縁層間に電源用薄膜配線導体層、接地用薄膜配線導体層及び信号用薄膜配線導体層を配してなる多層配線基板であって、前記電源用薄膜配線導体層及び接地用薄膜配線導体層は、その各々が複数の開口を格子状に配したメッシュ状をなしており、かつ電源用薄膜配線導体層の導体部が接地用薄膜配線導体層の開口に、また接地用薄膜配線導体層の導体部が電源用薄膜配線導体層の開口に各々対向していることを特徴とするものである。

【0014】また本発明は、前記メッシュ状をなす電源用薄膜配線導体層及び接地用薄膜配線導体層の各開口の面積が $2.5 \times 10^{-3} \text{ (mm}^2\text{)}$ 乃至 $90 \times 10^{-3} \text{ (mm}^2\text{)}$ であり、電源用薄膜配線導体層に設けた開口の全開口面積が電源用薄膜配線導体層の全面積に対し5%乃至30%、接地用薄膜配線導体層に設けた開口の全開口面積が接地用薄膜配線導体層の全面積に対し5%乃至30%であることを特徴とするものである。

【0015】本発明の多層配線基板によれば、絶縁基板上に薄膜形成技術によって配線を形成したことから配線の微細化が可能となり、配線を極めて高密度に形成することが可能となる。

【0016】また本発明の多層配線基板によれば、電源用薄膜配線導体層及び接地用薄膜配線導体層を複数の開口を格子状に配したメッシュ状となしたことから有機樹脂絶縁層を熱硬化させる際、不要なガスが発生したとしてもそのガスはメッシュの開口を通して外部に良好に放出されて有機樹脂絶縁層と電源用及び接地用の薄膜配線導体層との間に溜まることはなく、その結果、有機樹脂絶縁層と電源用及び接地用の薄膜配線導体層は確実に密着し、両者の接合強度を強固となすことができる。

【0017】更に本発明の多層配線基板によれば、電源用薄膜配線導体層の導体部を接地用薄膜配線導体層の開口に、また接地用薄膜配線導体層の導体部を電源用薄膜配線導体層の開口に各々対向させたことから電源用薄膜配線導体層と接地用薄膜配線導体層の間に配される有機

樹脂絶縁層の厚みが薄く、上下に貫通するボイド（穴）が形成されていたとしても電源用薄膜配線導体層と接地用薄膜配線導体層とが電気的に短絡することは殆どなく、その結果、多層配線基板としての機能を長期間にわたり発揮させることが可能となる。

【0018】

【発明の実施の形態】次に、本発明を添付図面に基づき詳細に説明する。図1は、本発明の多層配線基板の一実施例を示し、1は基板、2は多層配線部である。

10 【0019】前記基板1はその上面に4つの有機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3dと電源用薄膜配線導体層4a、接地用薄膜配線導体層4b、信号用薄膜配線導体層4c、4dの4つの薄膜配線導体層を交互に多層に配設してなる多層配線部2が形成されており、該多層配線部2を支持する支持部材として作用する。

【0020】前記基板1は酸化アルミニウム質焼結体やムライト質焼結体等の酸化物系セラミックス、或いは表面に酸化物膜を有する窒化アルミニウム質焼結体、炭化珪素質焼結体等の非酸化物系セラミックス、更にはガラス繊維を織り込んだ布にエポキシ樹脂を含浸させたガラスエポキシ樹脂等の電気絶縁材料で形成されており、例えば、酸化アルミニウム質焼結体で形成されている場合には、アルミナ、シリカ、カルシア、マグネシア等の原料粉末に適当な有機溶剤、溶媒を添加混合して泥漿状となすとともにこれを従来周知のドクターブレード法やカレンダーロール法を採用することによってセラミックグリーンシート（セラミック生シート）を形成し、しかる後、前記セラミックグリーンシートに適当な打ち抜き加工を施し、所定形状となすとともに高温（約1600℃）で焼成することによって、或いはアルミナ等の原料粉末に適当な有機溶剤、溶媒を添加混合して原料粉末を調整するとともに該原料粉末をプレス成形機によって所定形状に形成し、最後に前記成形体を約1600℃の温度で焼成することによって製作され、またガラスエポキシ樹脂から成る場合は、例えば、ガラス繊維を織り込んだ布にエポキシ樹脂の前駆体を含浸させるとともに該エポキシ樹脂前駆体を所定の温度で熱硬化させることによって製作される。

【0021】また前記基板1には上下両主面に貫通する孔径が例えば、直径 $300 \mu\text{m}$ ～ $500 \mu\text{m}$ の貫通孔5が形成されており、該貫通孔5の内壁には基板1の上下両主面に導出する導電層6が被着されている。

【0022】前記貫通孔5は後述する基板1の上面に形成される多層配線部2の電源用薄膜配線導体層4a、接地用薄膜配線導体層4b及び信号用薄膜配線導体層4c、4dと外部電気回路とを電気的に接続する、或いは基板1の上下両主面に多層配線部2を配設した場合には両主面の多層配線部2の電源用薄膜配線導体層4a、接地用薄膜配線導体層4b及び信号用薄膜配線導体層4c、4d同士を電気的に接続する導電層6を形成するた

めの形成孔として作用し、基板1にドリル孔あけ加工法を施すことによって基板1の所定位置に所定形状に形成される。

【0023】更に前記貫通孔5の内壁及び基板1の上下両主面に被着形成されている導電層6は例えば、銅やニッケル等の金属材料からなり、従来周知のめっき法及びエッチング法を採用することによって貫通孔5の内壁に両端を基板1の上下両主面に導出させた状態で被着形成される。

【0024】前記導電層6は基板1の主面に配設される多層配線部2の各薄膜配線導体層4a、4b、4c、4dを外部電気回路に電氣的に接続したり、基板1の上下両主面に配設される各々の多層配線部2の各薄膜配線導体層4a、4b、4c、4d同士を電氣的に接続する作用をなす。

【0025】また前記基板1に形成した貫通孔5はその内部にエポキシ樹脂からなる有機樹脂充填体7が充填されており、該有機樹脂充填体7によって貫通孔5が完全に埋められ、同時に有機樹脂充填体7の両端面が基板1の上下両主面に被着させた導電層6の面と同一平面となっている。

【0026】前記有機樹脂充填体7は基板1の上面及び／又は下面に後述する複数の有機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3dと電源用薄膜配線導体層4a、接地用薄膜配線導体層4b、信号用薄膜配線導体層4c、4dとからなる多層配線部2を形成する際、多層配線部2の各有機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3dと電源用薄膜配線導体層4a、接地用薄膜配線導体層4b、信号用薄膜配線導体層4c、4dの平坦化を維持する作用をなす。

【0027】なお、前記有機樹脂充填体7は基板1の貫通孔5内にエポキシ樹脂の前駆体を充填し、しかる後、これに80℃～200℃の温度を0.5～3時間印加し、完全に熱硬化させることによって基板1の貫通孔5内に充填される。

【0028】更に前記基板1はその上面に4つの有機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3dと電源用薄膜配線導体層4a、接地用薄膜配線導体層4b及び信号用薄膜配線導体層4c、4dとが交互に多層に配設された多層配線部2が形成されており、かつ該電源用薄膜配線導体層4a、接地用薄膜配線導体層4b及び信号用薄膜配線導体層4c、4dの各々は導電層6と電氣的に接続されている。

【0029】前記多層配線部2を構成する有機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3dは上下に位置する電源用薄膜配線導体層4a、接地用薄膜配線導体層4b、信号用薄膜配線導体層4c、4dの各々の電氣的絶縁を図る作用をなし、電源用薄膜配線導体層4a、接地用薄膜配線導体層4bは電子部品Aに電力を供給するとともに信号用薄膜配線導体層4c、4dの特性インピーダンスを整合させる作用を、また信号用薄膜配線導体層4c、4dは

電子部品Aに電気信号を伝搬する作用をなす。

【0030】前記多層配線部2の各有機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3dはエポキシ樹脂、ビスマレイミドポリアジド樹脂、ポリフェニレンエーテル樹脂、ふっ素樹脂等の有機樹脂から成り、例えば、エポキシ樹脂からなる場合、ビスフェノールA型エポキシ樹脂、ノボラック型エポキシ樹脂、グリシジルエステル型エポキシ樹脂等にアミン系硬化剤、イミダゾール系硬化剤、酸無水物系硬化剤等の硬化剤を添加混合してペースト状のエポキシ樹脂前駆体を得るとともに該エポキシ樹脂前駆体を基板1の上部にスピンコート法により被着させ、しかる後、これを80～200℃の熱で0.5～3時間熱処理し、熱硬化させることによって形成される。

【0031】また前記各有機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3dはその各々の所定位置に最小径が有機樹脂絶縁層の厚みに対して約1.5倍程度のスルーホール8が形成されており、該スルーホール8は後述する有機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3dを介して上下に位置する電源用薄膜配線導体層4a、接地用薄膜配線導体層4b、信号用薄膜配線導体層4c、4dの各々を電氣的に接続するスルーホール導体9を形成するための形成孔として作用する。

【0032】前記各有機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3dに設けるスルーホール8は、例えばフォトリソグラフィ技術、具体的には各有機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3d上にレジスト材を塗布するとともにこれに露光・現像を施すことによって所定位置に所定形状の窓部を形成し、次に前記レジスト材の窓部にエッチング液を配し、レジスト材の窓部に位置する有機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3dを除去して、有機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3dに穴（スルーホール）を形成し、最後に前記レジスト材を有機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3d上より剥離させ除去することによって行われる。

【0033】更に前記各有機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3dの各々の上面には所定パターンの電源用薄膜配線導体層4a、接地用薄膜配線導体層4b及び信号用薄膜配線導体層4c、4dが、また各有機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3dに設けたスルーホール8の内壁にはスルーホール導体9が各々配設されており、スルーホール導体9によって間に有機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3dを挟んで上下に位置する電源用薄膜配線導体層4a、接地用薄膜配線導体層4b、信号用薄膜配線導体層4c、4dの各々が電氣的に接続されるようになっていく。

【0034】前記各有機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3dの上面及びスルーホール8内に配設される電源用薄膜配線導体層4a、接地用薄膜配線導体層4b、信号用薄膜配線導体層4c、4d及びスルーホール導体9は銅、金、アルミニウム等の金属材料を無電解メッキ法や

10

20

30

40

50

蒸着法、スパッタリング法等の薄膜形成技術及びフォトリソグラフィ技術を採用することによって形成され、例えば、銅で形成されている場合には、有機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3dの上面及びスルーホール8の内表面に、硫酸銅0.06モル/リットル、ホルマリン0.3モル/リットル、水酸化ナトリウム0.35モル/リットル、エチレンジアミン四酢酸0.35モル/リットルから成る無電解銅メッキ浴を用いて厚さ1 μ m乃至40 μ mの銅層を被着させ、しかる後、前記銅層をフォトリソグラフィ技術により所定パターンに加工することによって各有機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3d間、及びスルーホール8の内壁に配設される。この場合、電源用薄膜配線導体層4a、接地用薄膜配線導体層4b、信号用薄膜配線導体層4c、4d及びスルーホール導体9は薄膜形成技術により形成されることから配線の微細化が可能であり、これによって電源用薄膜配線導体層4a、接地用薄膜配線導体層4b、信号用薄膜配線導体層4c、4dを極めて高密度に形成することが可能となる。

【0035】また前記電源用薄膜配線導体層4a及び接地用薄膜配線導体層4bは流れる電流が大きく、その流れる電流に耐え得るために広面積に形成されており、かつ複数の開口Hを格子状に配したメッシュ状となっている。

【0036】前記電源用薄膜配線導体層4a及び接地用薄膜配線導体層4bを複数の開口Hを格子状に配したメッシュ状としたのは有機樹脂絶縁層3a、3b等が熱硬化時に発生する不要なガスを外部に良好に放出するためであり、開口Hによって有機樹脂絶縁層3a、3bと電源用薄膜配線導体層4a及び接地用薄膜配線導体層4bとの間に不要なガスが溜まることはなく、その結果、有機樹脂絶縁層3a、3bと電源用薄膜配線導体層4a及び接地用薄膜配線導体層4bとは密着し、各々の接合強度を強固となすことができる。

【0037】前記電源用薄膜配線導体層4a及び接地用薄膜配線導体層4bに設ける複数の開口Hはその各々の開口面積が 2.5×10^{-3} (mm²)未満で、かつ全開口面積が電源用薄膜配線導体層4a及び接地用薄膜配線導体層4bの各々の全面積に対し5%未満となると有機樹脂絶縁層3a、3bが熱硬化する際に発生する不要なガスは外部に効率良く放出されるのが困難となり、また開口面積が 90×10^{-3} (mm²)を超え、かつ全開口面積が電源用薄膜配線導体層4a及び接地用薄膜配線導体層4bの各々の全面積に対し30%を超えると信号用薄膜配線導体層4c、4dの特性インピーダンスが不整合となり、電気信号を良好に伝搬させることができなくなる危険性がある。従って、前記電源用薄膜配線導体層4a及び接地用薄膜配線導体層4bに設ける複数の開口Hはその各々の開口面積が 2.5×10^{-3} (mm²)乃至 90×10^{-3} (mm²)、全開口面積が電源用薄膜配

線導体層4a及び接地用薄膜配線導体層4bの各々の全面積に対し5%乃至30%であることが好ましい。

【0038】更に前記電源用薄膜配線導体層4aの導体部は間に有機樹脂絶縁層3bを挟んで接地用薄膜配線導体層4bの開口Hと、また接地用薄膜配線導体層4bの導体部は間に有機樹脂絶縁層3bを挟んで電源用薄膜配線導体層4aの開口Hと各々対向している。そのため有機樹脂絶縁層3bの厚みが薄く、上下に貫通するボイド(穴)が形成されていたとしても電源用薄膜配線導体層4aと接地用薄膜配線導体層4bとは電氣的に短絡することが殆どなく、その結果、多層配線基板としての機能を長期間にわたり発揮させることが可能となる。

【0039】なお、前記有機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3dと電源用薄膜配線導体層4a、接地用薄膜配線導体層4b、信号用薄膜配線導体層4c、4dとを交互に多層に配設して形成される多層配線部2は各有機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3dの上面を中心線平均粗さ(Ra)で $0.05 \mu\text{m} \leq Ra \leq 5 \mu\text{m}$ の粗面としておくと、有機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3dと電源用薄膜配線導体層4a、接地用薄膜配線導体層4b、信号用薄膜配線導体層4c、4dとの接合及び上下に位置する有機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3d同士の接合を強固となすことができる。従って、前記多層配線部2の各有機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3dはその上面をエッチング加工等によって粗し、中心線平均粗さ(Ra)で $0.05 \mu\text{m} \leq Ra \leq 5 \mu\text{m}$ の粗面としておくことが好ましい。

【0040】また前記有機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3dはその各々の厚みが100 μ mを超えると有機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3dにフォトリソグラフィ技術を採用することによってスルーホール8を形成する際、エッチング加工時間が長くなって、スルーホール8を所望する鮮明な形状に形成するのが困難となり、また5 μ m未満となると有機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3dの上面に上下に位置する有機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3dの接合強度を上げるための粗面加工を施す際、有機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3dに不要な穴が形成され、上下に位置する電源用薄膜配線導体層4a、接地用薄膜配線導体層4b、信号用薄膜配線導体層4c、4dに不要な電氣的短絡を招来してしまう危険性がある。

【0041】従って、前記有機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3dはその各々の厚みを5 μ m～100 μ mの範囲としておくことが好ましい。

【0042】更に前記多層配線部2の電源用薄膜配線導体層4a、接地用薄膜配線導体層4b、及び信号用薄膜配線導体層4c、4dはその厚みが1 μ m未満であると各々の電気抵抗が大きなものとなり、また40 μ mを超えると電源用薄膜配線導体層4a、接地用薄膜配線導体層4b、及び信号用薄膜配線導体層4c、4dを有

機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3dに被着させる際に電源用薄膜配線導体層4a、接地用薄膜配線導体層4b、及び信号用薄膜配線導体層4c、4dの内部に大きな応力が内在し、該内在応力によって電源用薄膜配線導体層4a、接地用薄膜配線導体層4b、及び信号用薄膜配線導体層4c、4dが有機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3dから剥離し易いものとなる。従って、前記多層配線部2の電源用薄膜配線導体層4a、接地用薄膜配線導体層4b、及び信号用薄膜配線導体層4c、4dの厚みは1 μ m～40 μ mの範囲としておくことが好ましい。

【0043】前記有機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3dと電源用薄膜配線導体層4a、接地用薄膜配線導体層4b、及び信号用薄膜配線導体層4c、4dとを交互に多層に積層して形成される多層配線部2は更に、最上層の有機樹脂絶縁層3dの上面に電源用薄膜配線導体層4a、接地用薄膜配線導体層4b、及び信号用薄膜配線導体層4c、4dと電氣的に接続しているボンディングパッド10が配設されている(図1では信号用薄膜配線導体層4dに接続されたボンディングパッド10のみが記載されている。)

【0044】前記ボンディングパッド10は、その上部に半導体素子等の能動部品や容量素子、抵抗器等の受動部品から成る電子部品Aの電源端子、接地端子及び信号端子が熱圧着等により接合され、これによって半導体素子等の能動部品及び容量素子、抵抗器等の受動部品から成る電子部品Aが電源用薄膜配線導体層4a、接地用薄膜配線導体層4b、及び信号用薄膜配線導体層4c、4dに電氣的に接続されることとなる。

【0045】前記ボンディングパッド10は、電源用薄膜配線導体層4a、接地用薄膜配線導体層4b、及び信号用薄膜配線導体層4c、4dと同じ金属材料、具体的には銅、ニッケル、金、アルミニウム等の金属材料から成り、最上層の有機樹脂絶縁層3d上に電源用薄膜配線導体層4a、接地用薄膜配線導体層4b、及び信号用薄膜配線導体層4c、4dを形成する際に同時に前記電源用薄膜配線導体層4a、接地用薄膜配線導体層4b、及び信号用薄膜配線導体層4c、4dと電氣的接続をもって形成される。

【0046】かくして本発明の多層配線基板によれば、最上層の有機樹脂絶縁層3d表面に設けたボンディングパッド10に半導体素子等の能動部品や容量素子、抵抗器等の受動部品から成る電子部品Aの電源端子、接地端子及び信号端子を熱圧着等により接合させ、電源用薄膜配線導体層4a、接地用薄膜配線導体層4b、及び信号用薄膜配線導体層4c、4dに電子部品Aを電氣的に接続させることによって半導体装置や混成集積回路装置となり、電源用薄膜配線導体層4a、接地用薄膜配線導体層4b、及び信号用薄膜配線導体層4c、4dの一部を *

* 外部電気回路に接続させれば前記半導体素子や容量素子等は外部電気回路に電氣的に接続されることとなる。

【0047】なお、本発明は上述の実施例に限定されるのではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲であれば種々の変更は可能であり、例えば、上述の実施例においては基板1の上面のみに複数の有機樹脂絶縁層3a、3b、3c、3dと電源用薄膜配線導体層4a、接地用薄膜配線導体層4b、及び信号用薄膜配線導体層4c、4dとを交互に多層に積層して形成される多層配線部2を配設したが、該多層配線部2を基板1の下側のみに設けても、上下の両面に設けてもよい。

【0048】

【発明の効果】本発明の多層配線基板によれば、絶縁基板上に薄膜形成技術によって配線を形成したことから配線の微細化が可能となり、配線を極めて高密度に形成することが可能となる。

【0049】また本発明の多層配線基板によれば、電源用薄膜配線導体層及び接地用薄膜配線導体層を複数の開口を格子状に配したメッシュ状となしたことから有機樹脂絶縁層を熱硬化させる際、不要なガスが発生したとしてもそのガスはメッシュの開口を通して外部に良好に放出されて有機樹脂絶縁層と電源用及び接地用の薄膜配線導体層との間に溜まることはなく、その結果、有機樹脂絶縁層と電源用及び接地用の薄膜配線導体層は確実に密着し、両者の接合強度を強固となすことができる。

【0050】更に本発明の多層配線基板によれば、電源用薄膜配線導体層の導体部を接地用薄膜配線導体層の開口に、また接地用薄膜配線導体層の導体部を電源用薄膜配線導体層の開口に各々対向させたことから電源用薄膜配線導体層と接地用薄膜配線導体層の間に配される有機樹脂絶縁層の厚みが薄く、上下に貫通するボイド(穴)が形成されていたとしても電源用薄膜配線導体層と接地用薄膜配線導体層とが電氣的に短絡することは殆どなく、その結果、多層配線基板としての機能を長期間にわたり発揮させることが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の多層配線基板の一実施例を示す断面図である。

【符号の説明】

1・・・基板
2・・・多層配線部
3a、3b、3c、3d・・・有機樹脂絶縁層
4a・・・電源用薄膜配線導体層
4b・・・接地用薄膜配線導体層
4c、4d・・・信号用薄膜配線導体層
A・・・電子部品
H・・・電源用薄膜配線導体層及び接地用薄膜配線導体層に設けた開口

【図1】

